下载日志已记录，仅供内部参考

证券研究报告 行业周报

华鑫证券 CHINA FORTUNE SECURITIES

# 长江存储科创板IPO获受理，AI算力与内存增速差或将扩大

## AI算力行业周报

投资评级： 推荐 （维持 ）

报告日期： 2026年08月24日


- **分析师：庄宇**
- SAC编号：S1050525120003
- **联系人：石俊烨**
- SAC编号：S1050125060011


研究创造价值

下载日志已记录，仅供内部参考



## 美光Hot Chips 2026剖析AI"内存墙"瓶颈，算力两年增长3倍而内存能力增长不足2倍

8月23日，在美国斯坦福大学举行的Hot Chips 2026半导体大会上，美光（Micron）HBM设计架构研究员Raghu Sreeramaneni深入剖析了AI系统面临的"内存墙"问题。他指出，计算能力大约每两年增长3倍，而内存能力每两年仅增长不到2倍，两者增速差距意味着内存墙不仅持续存在，而且可能进一步加剧。

在典型的AI加速器中，大量计算工作受限于内存传输速度，处理器不得不频繁等待数据送达。美光透露，在一个典型的GPU系统单晶片封装（SiP）中，若采用4个12层的HBM堆叠，其内存硅芯片面积占整个封装总硅芯片面积的90%左右，相当于GPU硅芯片面积的8倍。相较传统DDR5内存，HBM系统可提供高达5.3 TB/s的系统级带宽，性能高出15至17倍；HBM3E单颗晶圆带宽高达256 GB/s，高出DDR5的32倍。为解决带宽不足，现行芯片封装被迫堆叠更多HBM，但这也带来严峻的散热与机械结构挑战。美光已推出HBM4，信道数翻倍、I/O速度提升两倍，系统带宽最高可达2,800 GB/s。在散热与封装方面，美光强调业界必须转向液冷与混合键合，并正研发融合键合等下一代先进封装技术，以支持更精密的间距并显著降低热阻。

## 长江存储科创板IPO获上交所受理，拟募资330亿元

8月21日晚间，国产NAND Flash龙头长江存储控股股份有限公司的科创板IPO申请获上交所受理。招股书显示，长江存储2025年营收631.85亿元，归母净利润142.11亿元；2026年一季度营收470.42亿元，归母净利润333.79亿元，净利润率约71%。

本次拟公开发行A股股票不低于19.8亿股且不超过24.3亿股，募集资金的总投资额高达330亿元，其中208亿元投向量产线技术升级项目，122亿元投向研发相关募投项目。2026年1-3月，公司在全球NAND Flash厂商中按销售金额和出货量排名均位列全球第三、中国第一，2026年一季度主营业务毛利率高达76.79%，NAND Flash产能利用率升至98.02%。公司自主研发的晶栈Xtacking架构已迭代至第四代，成为全球首批突破200层NAND技术的企业之一，并已与三星电子签署混合键合技术专利许可协议。

从股权结构看，长江存储无实际控制人，湖北长晟（26.54%）、芯飞科技（25.35%）、国家大基金一期（11.97%）、国家大基金二期（11.38%）等为前五大股东。公司警示称，若未来市场需求增速放缓或主要存储厂商快速扩产导致供给大幅增加，产品价格可能回落，且技术路线误判或产品迭代不及预期将严重影响业绩。

建议关注：优迅股份、华虹宏力、长鑫科技。

下载日志已记录，仅供内部参考

# 重点关注公司及盈利预测



| 公司代码 | 名称 | 2026-08-24 股价 | EPS | | | PE | | | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026E | 2027E | 2025 | 2026E | 2027E | |
| 688347.SH | 华虹宏力 | 229.03 | 0.01 | 0.51 | 0.83 | 22903.00 | 449.08 | 275.94 | 增持 |
| 688807.SH | 优迅股份 | 335.00 | 1.1 | 1.39 | 1.77 | 304.55 | 241.01 | 189.27 | 未评级 |
| 688825.SH | 长鑫科技 | 56.60 | 0.03 | 2.17 | 3.66 | 1886.67 | 26.08 | 15.46 | 买入 |

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

下载日志已记录，仅供内部参考

# 风 险 提 示



中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

下载日志已记录，仅供内部参考

# 目录

CONTENTS

1. 算力板块周度行情分析

2. 行业动态

3. 公司公告

下载日志已记录，仅供内部参考

# 01 算力板块周度行情分析

研究创造价值

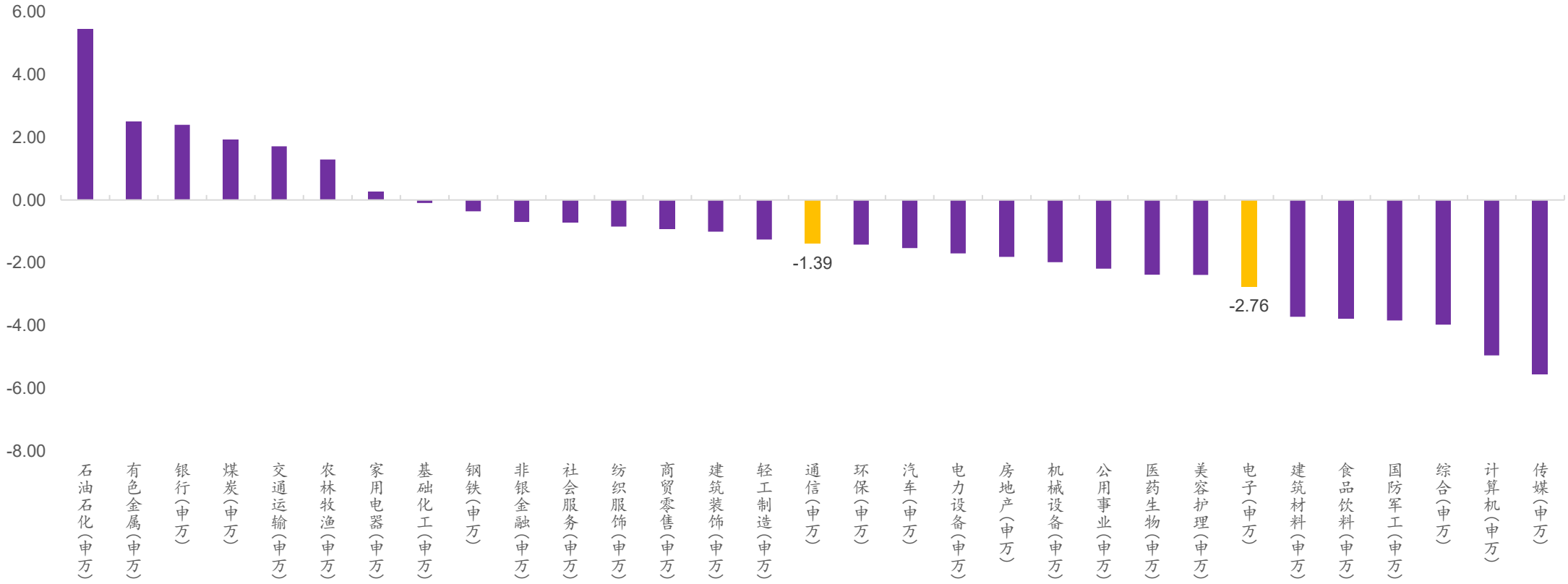
下载日志已记录，仅供内部参考

# 1.1、申万一级行业周涨跌幅



跨行业比较，8月17日-8月21日当周，申万一级行业整体呈分化态势。其中通信行业下跌1.39%，位列第16位；电子行业下跌2.76%，位列第25位。

图表2：8月17日-8月21日申万一级行业周涨跌幅比较（%）



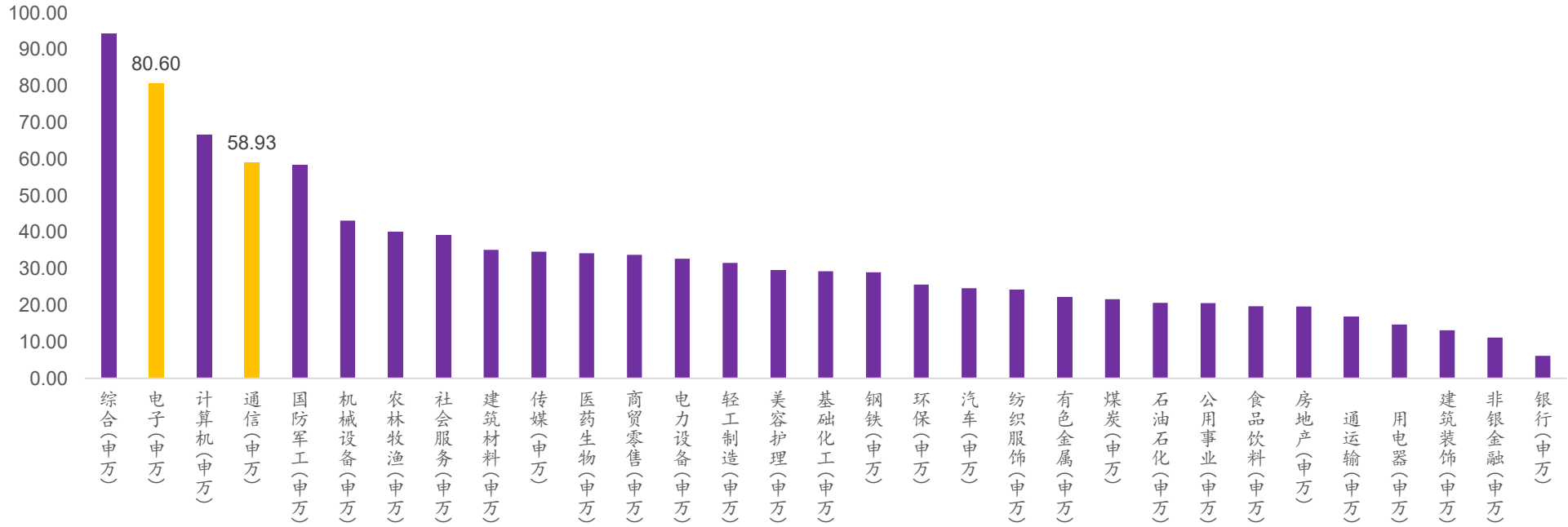

资料来源：wind，华鑫证券研究

下载日志已记录，仅供内部参考

# 1.2、申万一级行业估值水平

跨行业比较，8月17日-8月21日当周，估值前三的行业为综合，电子和计算机行业，其中电子、通信行业的市盈率分别为80.60，58.93。

图表3：8月17日-8月21日申万一级行业市盈率比较




资料来源：wind，华鑫证券研究

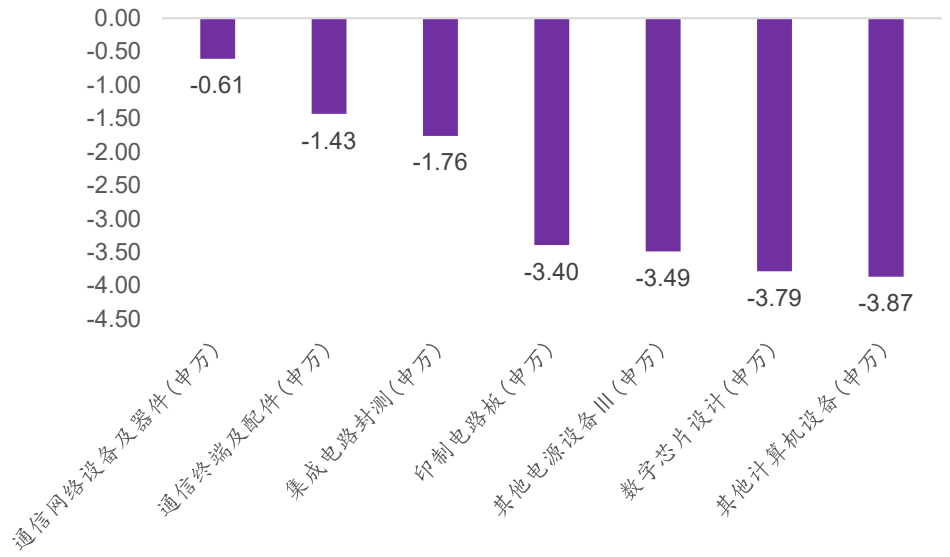
下载日志已记录，仅供内部参考

# 1.3、AI算力细分板块周度行情梳理

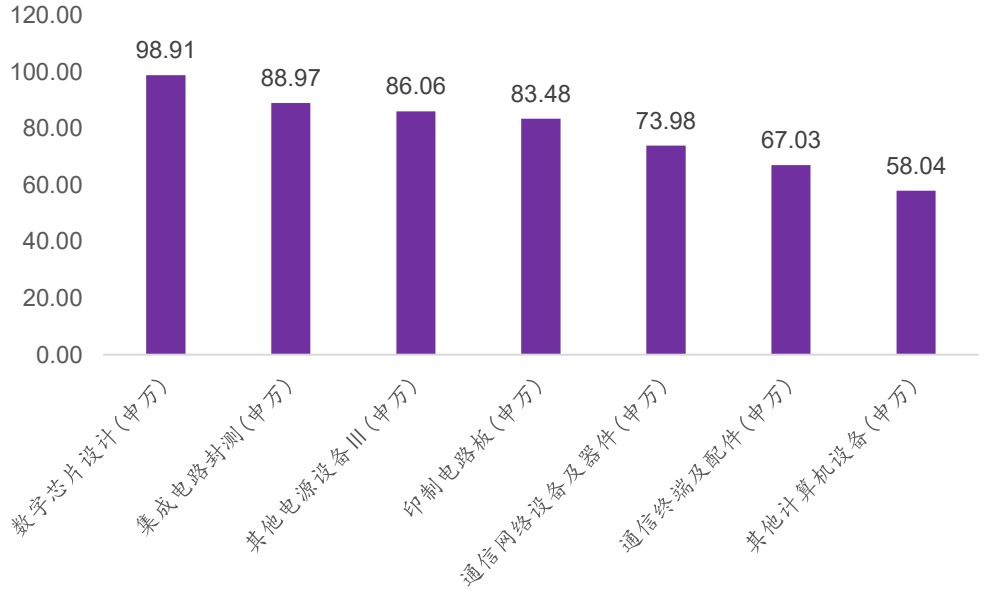


AI算力相关细分板块比较，8月17日-8月21日当周，AI算力相关细分板块呈下跌态势。其中，通信网络设备及器件板块跌幅最小，达到-0.61%。其他计算机设备板块跌幅最大，达到-3.87%。估值方面，数字芯片设计、集成电路封测和其他电源设备Ⅲ板块估值水平位列前三。

图表4：8月17日-8月21日AI算力相关细分板块周涨跌幅比较（%）




图表5：8月17日-8月21日AI算力相关细分板块市盈率比较




资料来源：wind，华鑫证券研究

下载日志已记录，仅供内部参考

# 1.4、申万一级行业板块资金流向



上周申万一级行业资金流向情况：

上周电子板块主力净流出382.90亿元，主力净流入率为-1.16%，在31个申万一级行业中排第20名；通信板块主力净流出144.24亿元，主力净流入率为-1.48%，在31个申万一级行业中排第26名。

图表6：8月17日-8月21日申万一级行业资金流向情况

| 行业 | 主力流入额(万元) | 主力流出额(万元) | 主力净流入额(万元) | 主力净流入率(%) | 连续流入天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW农林牧渔 | 4,489,269.02 | 4,208,193.12 | 281,075.90 | 1.79 | -1 |
| SW综合 | 643,085.28 | 602,475.22 | 40,610.06 | 1.72 | 5 |
| SW煤炭 | 1,312,352.76 | 1,274,155.32 | 38,197.44 | 0.61 | -2 |
| SW商贸零售 | 1,663,755.35 | 1,637,390.18 | 26,366.54 | 0.37 | 2 |
| SW房地产 | 2,205,523.99 | 2,179,061.12 | 26,462.87 | 0.32 | -1 |
| SW汽车 | 7,161,078.08 | 7,073,978.16 | 87,099.92 | 0.32 | 2 |
| SW钢铁 | 902,881.57 | 896,928.49 | 5,953.09 | 0.18 | 1 |
| SW基础化工 | 15,895,577.33 | 15,889,646.23 | 5,931.10 | 0.01 | 2 |
| SW石油石化 | 2,468,586.36 | 2,470,471.43 | -1,885.06 | -0.02 | 1 |
| SW有色金属 | 22,910,367.18 | 22,936,639.76 | -26,272.59 | -0.04 | 2 |
| SW建筑装饰 | 3,775,200.42 | 3,786,480.70 | -11,280.27 | -0.08 | 2 |
| SW交通运输 | 2,379,056.92 | 2,390,773.96 | -11,717.04 | -0.11 | -1 |
| SW家用电器 | 2,952,915.90 | 2,973,842.54 | -20,926.64 | -0.21 | 1 |
| SW纺织服饰 | 1,205,434.79 | 1,225,182.53 | -19,747.75 | -0.37 | 1 |
| SW社会服务 | 1,281,697.95 | 1,304,243.33 | -22,545.38 | -0.43 | -4 |
| SW轻工制造 | 1,505,506.66 | 1,537,307.18 | -31,800.52 | -0.44 | 2 |
| SW医药生物 | 25,927,720.15 | 26,392,506.60 | -464,786.45 | -0.52 | -1 |
| SW机械设备 | 28,373,239.38 | 28,941,118.00 | -567,878.62 | -0.65 | 1 |
| SW公用事业 | 4,074,467.13 | 4,263,544.53 | -189,077.39 | -1.04 | -1 |
| SW电子 | 126,012,833.85 | 129,841,809.07 | -3,828,975.22 | -1.16 | 1 |
| SW食品饮料 | 4,421,773.74 | 4,617,205.83 | -195,432.09 | -1.17 | -3 |
| SW环保 | 2,077,569.84 | 2,178,874.04 | -101,304.19 | -1.30 | 1 |
| SW美容护理 | 381,271.78 | 405,717.97 | -24,446.19 | -1.33 | -1 |
| SW非银金融 | 4,884,796.32 | 5,097,677.07 | -212,880.74 | -1.35 | 2 |
| SW电力设备 | 23,489,123.81 | 24,575,847.68 | -1,086,722.02 | -1.37 | 1 |
| SW通信 | 40,591,332.66 | 42,033,724.55 | -1,442,391.89 | -1.48 | 2 |
| SW国防军工 | 5,939,259.68 | 6,324,685.74 | -385,426.07 | -1.65 | -5 |
| SW银行 | 4,375,499.21 | 4,621,279.66 | -245,780.45 | -1.76 | -4 |
| SW建筑材料 | 4,220,188.81 | 4,599,934.22 | -379,745.42 | -2.56 | -4 |
| SW计算机 | 17,287,021.02 | 19,048,521.57 | -1,761,500.55 | -3.01 | -5 |
| SW传媒 | 5,222,654.06 | 5,805,197.09 | -582,543.03 | -3.14 | -1 |

资料来源：wind，华鑫证券研究

下载日志已记录，仅供内部参考



# 1.5、AI算力细分板块资金流向

AI算力相关板块资金流向情况：
上周通信终端及配件板块主力净流入0.61亿元，主力净流入率为0.07%，在8个子行业中排第1名；集成电路制造板块主力净流出27.99亿元，主力净流入率为-3.22%，在8个子行业中排第8名。

图表7：8月17日-8月21日AI算力相关行业资金流向情况

| 序号 | 行业 | 主力流入额(万元) | 主力流出额(万元) | 主力净流入额(万元) | 主力净流入率(%) | 连续流入天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW通信终端及配件 | 2,564,235.86 | 2,558,101.19 | 6,134.67 | 0.07 | 2 |
| 2 | SW数字芯片设计 | 34,872,423.06 | 35,488,067.77 | -615,644.71 | -0.82 | 1 |
| 3 | SW集成电路封测 | 5,771,916.42 | 5,992,588.69 | -220,672.27 | -1.23 | 1 |
| 4 | SW通信网络设备及器件 | 29,028,664.04 | 30,151,977.99 | -1,123,313.95 | -1.92 | 1 |
| 5 | SW其他计算机设备 | 3,246,753.02 | 3,467,048.76 | -220,295.74 | -2.00 | 1 |
| 6 | SW印制电路板 | 16,373,737.22 | 17,368,620.69 | -994,883.46 | -2.27 | 2 |
| 7 | SW其他电源设备III | 2,205,544.74 | 2,395,972.80 | -190,428.07 | -2.71 | 1 |
| 8 | SW集成电路制造 | 2,950,131.79 | 3,230,055.67 | -279,923.88 | -3.22 | -5 |

资料来源：wind，华鑫证券研究

下载日志已记录，仅供内部参考

# 1.6、AI算力：PCB板块行情复盘



随着 5G 通信、人工智能、大数据中心、汽车电动化和智能化等新兴技术的快速发展对 PCB 的需求在数量和质量上都提出了更高要求。例如，5G 基站建设需要大量高频、高速 PCB 板以实现信号的高速传输；汽车智能化使得汽车电子系统日益复杂，对车用 PCB 的可靠性和性能要求大幅提升。

过去几十年，PCB 产业经历了从欧美向日本、台湾地区，再向中国大陆的转移过程。目前，中国大陆已成为全球最大的 PCB 生产基地，拥有完整的产业链和成本优势。未来，随着新兴市场的崛起，产业可能进一步向具有成本和技术优势的地区转移，同时供应链也将更加多元化和区域化。

PCB 行业呈现出一定的集中化趋势，头部企业在技术研发、资金实力、客户资源等方面具有明显优势，能够更好地应对市场变化和竞争挑战。头部企业通过不断扩大产能、提升技术水平和拓展市场份额，进一步巩固了其市场地位。

中低端PCB市场，由于进入门槛相对较低，竞争较为激烈，企业主要通过价格战来争夺市场份额。而在高端市场，如高多层板、高频高速板、封装基板等领域，技术壁垒较高，企业需要不断投入研发，提升产品质量和性能，以差异化竞争获取市场份额。

中国台湾拥有完善的PCB产业链，从上游的覆铜板、铜箔、玻纤布等原材料生产，到中游的PCB制造，再到下游的电子组装和应用，包括终端客户的认证等各方面都具备很强的优势和竞争力。完善的产业链配套体系使得台湾 PCB产业在全球范围内都具有很强的竞争力。因此，中国台湾PCB产业链上下游公司的营收具备一定的代表性，反映行业的发展趋势和景气度。

中游PCB厂商：从长期的维度来看，2023-2025年PCB行业经历了从衰退到复苏的阶段。2023年全年大部分月份营收同比增长率为负，行业处于衰退状态。但从2024年开始，同比增长率逐渐转正，行业进入复苏阶段，并在2025年行业整体实现了较为稳定的增长。这表明 PCB行业经历了一段下行时期之后，逐渐走出低谷，迎来了新的发展机遇。

下载日志已记录，仅供内部参考

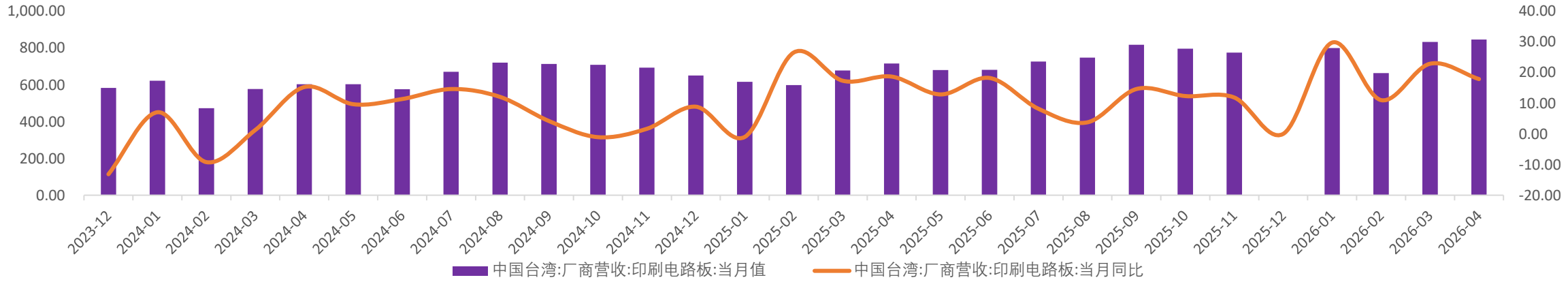
# 1.6、AI算力：PCB板块行情复盘



从中期的维度来看，对比2024年和2025年的数据可以发现，行业从2024年初开始逐步复苏。2024 年 1 月台湾PCB厂商营收为 622.53 亿新台币，同比增长7.05%。2025年，台湾PCB厂商营收规模进一步扩大，增长率也保持在较高水平。尽管行业整体呈现增长趋势，但增长速度并不稳定。在2024年和2025年中，同比增长率都有较大幅度的波动，2024年2 月增长率为- 9.21%，之后又逐渐回升；2025年1月为- 0.99%，而2025年2月增长率为26.53%。波动的增长率反映出潜在的市场需求变化、季节性变化以及原材料价格波动等因素的影响。

从短期来看，下游AI算力需求旺盛带动AI-PCB需求提升。2024年以来，各月营收当月值整体处于较高水平，除 2024 年 4 月为472.82亿新台币外，其余月份均在500亿新台币以上，且有个别月份超过 800 亿新台币。2025年11月，中国台湾PCB厂商营收达到774.72亿新台币，同比增长11.86%。2026年开年营收当月值处于较高水平，达到799.67亿新台币，同比增长29.77%。2026年4月当月值较开年营收进一步上升，达到845.58亿新台币，**同比增长17.87%**。

图表8：2023-2026年中国台湾印制电路板厂商营收及同比增速(亿新台币)




资料来源：wind，华鑫证券研究

下载日志已记录，仅供内部参考

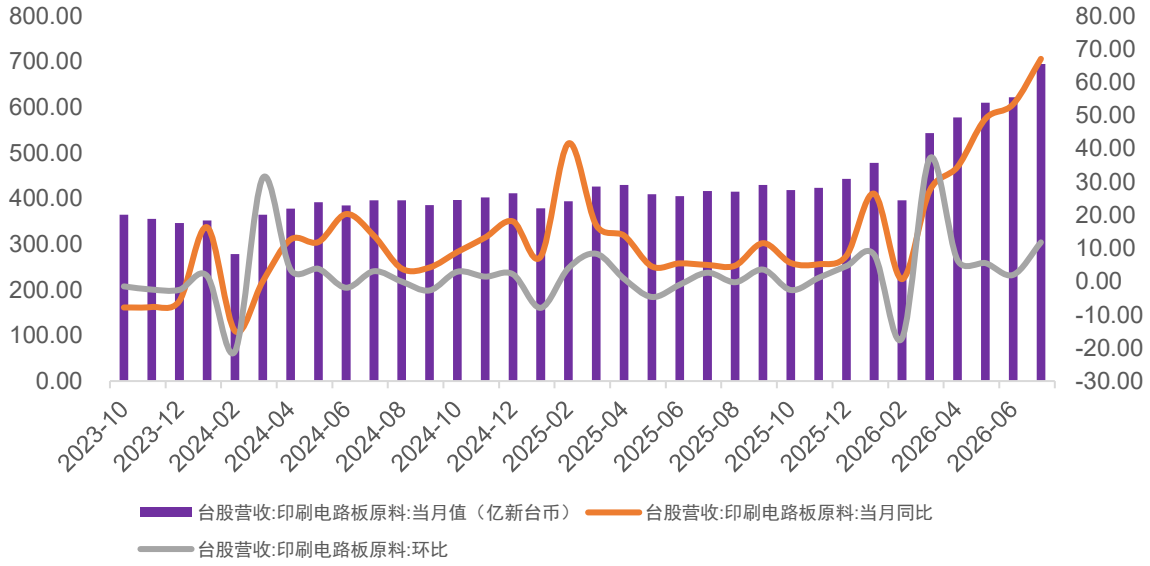
# 1.6、AI算力：PCB板块行情复盘



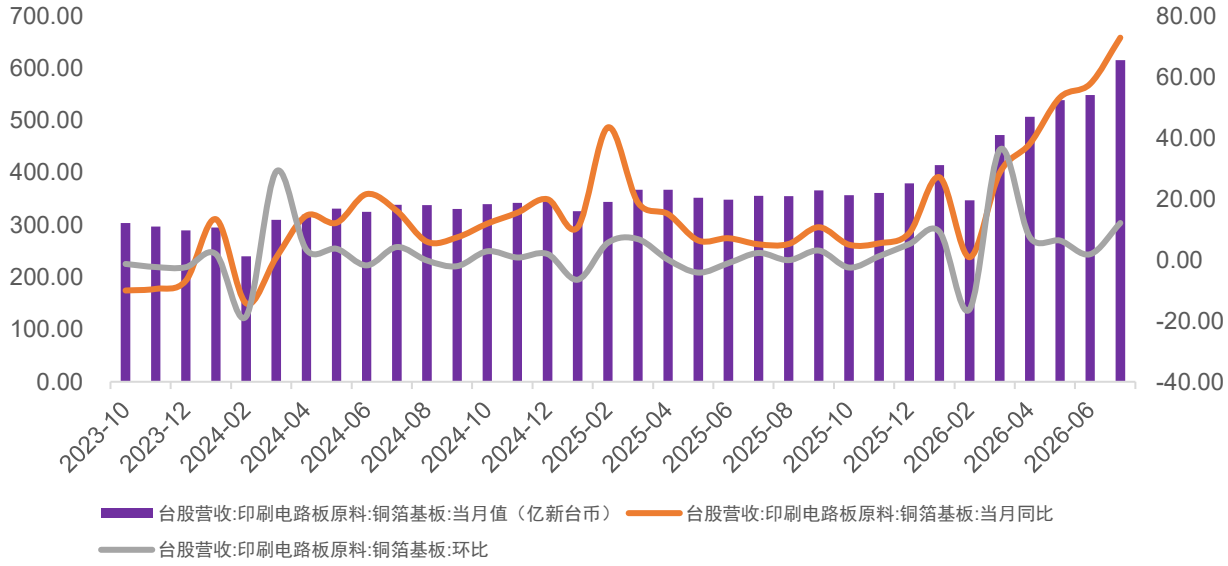
上游PCB基材厂商：5G、人工智能、汽车电子等新兴产业的发展对PCB上游基材提出新的要求，市场对于高频高速覆铜板和铜箔等材料的需求升级，M8-M9高频高速覆铜板和低表面粗糙度电子铜箔成为高端AI服务器的刚需。通常来说，PCB上游基材的市场需求存在一定的季节性变化，第一季度通常是需求淡季，第四季度可能是需求旺季。

从最新的数据来看，2026年7月，中国台湾PCB原料厂商实现营收694.57亿新台币，同比增长67.03%，环比增长11.76%；中国台湾铜箔基板厂商实现营收614.82亿新台币，同比增长72.82%，环比增长12.05%。

图表9：2023-2026年台湾印制电路板原料厂商营收及增速（亿新台币）




图表10：2023-2026年台湾铜箔基板厂商营收及增速（亿新台币）




资料来源：wind，华鑫证券研究

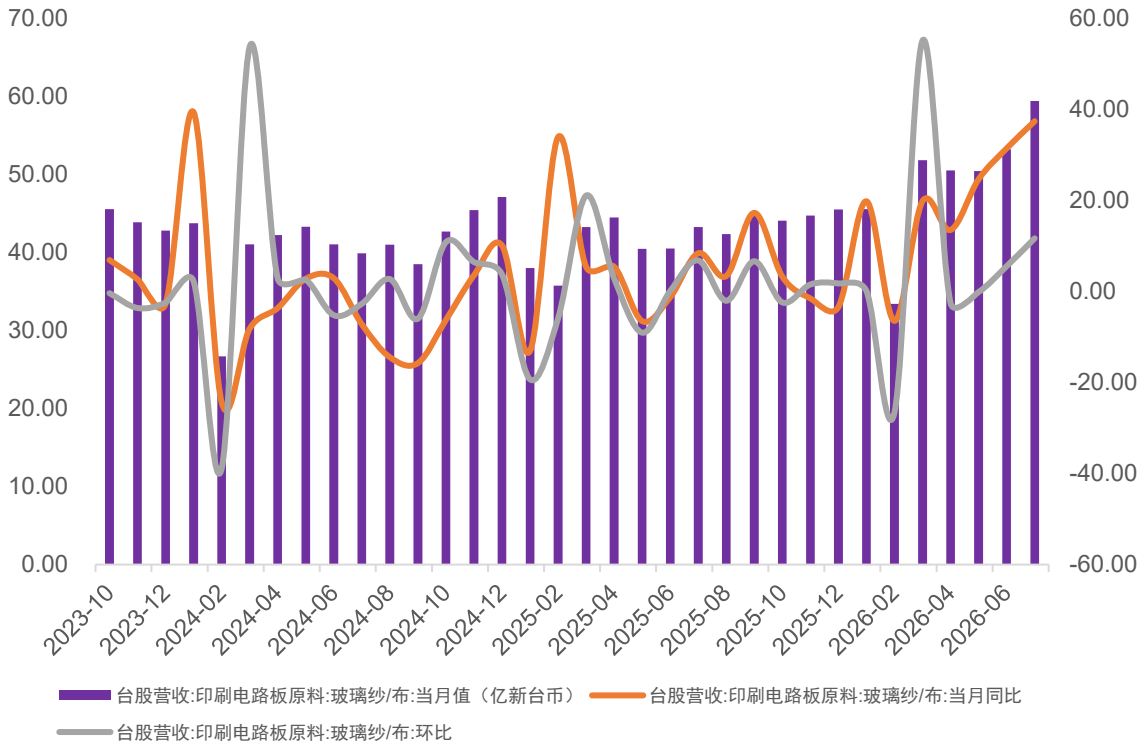
下载日志已记录，仅供内部参考

# 1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

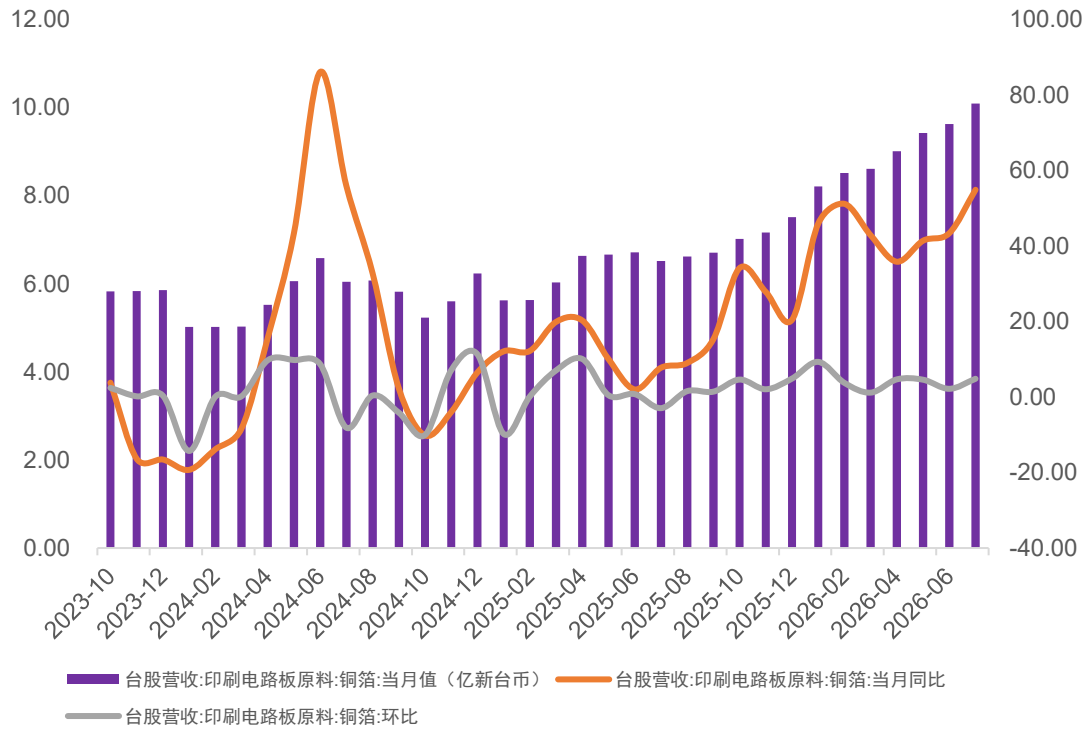


中国台湾电子布厂商实现营收59.38亿新台币，同比增长37.36%，环比增长11.65%；中国台湾电子铜箔厂商实现营收10.09亿新台币，同比增长54.87%；环比增长4.82%。

图表11：2023-2026年台湾电子布厂商营收及增速（亿新台币）




图表12：2023-2026年台湾电子铜箔厂商营收及增速（亿新台币）




资料来源：wind，华鑫证券研究

下载日志已记录，仅供内部参考

# 02 行　业　动　态

研究创造价值

下载日志已记录，仅供内部参考



## 地平线征程6B驶入量产快车道，再次斩获千万套级别订单

据博世官方消息，其基于地平线征程6B芯片研发的第四代多功能摄像头（MPC4）已斩获大规模量产定点。截至目前，该平台定点已覆盖40余款车型、整体订单规模达到千万套级别，其首个定点项目将于2026年第三季度正式量产，后续中国及海外多个车企客户项目依次投产，全球化规模交付稳步推进。作为双方深度协同打造的平台化方案，博世MPC4的规模交付既验证了地平线征程6B的车规级可靠性与工程化成熟度，也表明中国智驾方案正深度融入全球汽车产业供应链体系。

当前，智能辅助驾驶正加速向主流乘用车市场渗透，入门级车型对高可靠、高性价比智驾方案的需求日益迫切。地平线征程6B正是地平线面向这一趋势打造的车规级智能驾驶芯片，以“小算力、大智慧”为核心定位，专为入门级智能驾驶场景深度优化，该芯片搭载地平线自研BPU纳什架构，可高效支持Transformer等主流智驾算法，稳定承载L2级辅助驾驶、主动安全、行车泊车一体化等核心功能，全面满足C-NCAP、E-NCAP等全球主流安全法规标准，具备高稳定性、高可靠性、易适配、可快速量产的突出优势，能够帮助车企以可控成本快速完成智驾功能的全系标配。

地平线专注于核心算力芯片与基础工具链研发，协同全球Tier1、算法厂商等产业链伙伴，共同打造适配不同场景的智驾方案。目前，博世、电装、欧摩威等全球顶级Tier1供应商均已选择征程6B作为高性价比智驾方案的开发基座。随着这些平台化项目在全球多区域进入量产，征程6B的全球化布局正在进入集中收获期。

下载日志已记录，仅供内部参考



## Cerebras发布CS-4：集成3颗WSE-3T芯片

当地时间8月18日，晶圆级AI芯片公司Cerebras Systems在美国旧金山举办的SUPERNOVA发布会上，正式推出新一代机架级AI系统Cerebras CS-4，其速度达到了 CS-3 的2倍，并且其在每用户每秒Token吞吐量上相比GPU的优势扩大到了30倍。

据介绍，机架级 CS-4 系统搭载了三颗最新发布的Wafer Scale Engine 3 Turbo（WSE-3T）芯片，基于台积电5nm制程制造，这是迄今为止规模最大的AI处理器，每颗芯片面积为46,225平方毫米，集成4万亿个晶体管和90万个AI优化核心，44GB SRAM。相比前代，WSE-3T将单颗晶圆的AI算力翻倍至250 PFLOPS，内存带宽翻倍至43.2 PB/s。

由于内存带宽是决定速度和吞吐量的关键因素，这带来了两者的阶跃式提升。片上结构带宽和片外I/O也分别翻倍至53.5 PB/s和2.4 Tbps。I/O延迟从5微秒缩短至低至2微秒。

这也使得CS-4系统整体可提供750 PFLOPS的AI算力、每秒129.6 PB的内存带宽以及每秒7.2 Tbps的I/O吞吐量，速度是前代CS-3系统的两倍。总计算结构带宽跃升至160.5 PB/s，从而能够创建超大规模集群并支持超过50万亿参数的模型。

下载日志已记录，仅供内部参考



## ADI单季营收首破40亿美元，AI相关营收占比已达20%

当地时间8月19日，模拟芯片巨头Analog Devices（ADI）公布了截至2026年8月1日的2026财年第三季度业绩，营收与利润双双超越市场预期，并给出了远超分析师预测的强劲下季度指引，凸显了其在新一轮AI浪潮中的强势地位。

财报数据显示，ADI在第三财季实现营收40.22亿美元，同比增长40%，环比增长11%，这是公司历史上首次单季营收突破40亿美元大关。

AI相关业务占比已达20%：ADI首席执行官Vincent Roche及首席财务官Richard Puccio在电话会中表示，公司将ATE（自动测试设备）与数据中心业务合并视为其“AI暴露度”，这两部分业务合计目前占ADI整体业务的20%，并拥有多年的强劲增长势头，这一信心源于强大的设计导入（design-in）活动、积压订单和预订动能。

在数据中心内部，ADI的光学和电源产品均实现了超过100%的同比增长。公司预计，其光学电路交换（OCS）收入将在本财年翻倍，并有望在2027年再次实现类似增长。

下载日志已记录，仅供内部参考



## 谦合益邦打造全球首款4层3D DRAM存算一体芯片

近日，3D存算一体芯片领军企业谦合益邦宣布，其自主研发的全球首款4层3D DRAM堆叠存算一体芯片成功回片并点亮，标志着4层3D DRAM堆叠存算一体芯片从技术验证正式迈入工程落地阶段。

该芯片采用谦合益邦自研的全新三维集成原生计算架构与3D DRAM堆叠技术，在全球范围内首次实现4层芯片在垂直方向的高密度集成，将计算单元与存储单元在三维空间中深度融合，从根本上突破了传统平面架构下计算与存储分离带来的“内存墙”瓶颈。

通过采用全新的三维集成原生计算架构，该芯片实现了全方位的性能跃升：数据访存带宽较传统方案提升一个数量级，访存功耗和延时降低一个数量级，单位时间数据处理吞吐量提升一个数量级，单次数据处理成本下降一个数量级。这一系列指标的系统性突破，为以云游戏为代表的大规模并行计算与高并发数据流处理场景，提供了全新的硬件加速范式。

谦合益邦成立于2024年1月，是由网易孵化的国内最早专注于3D存算一体、三维集成原生芯片架构和云游戏应用加速的芯片公司。近期，公司刚完成超20亿元的B轮融资，网易有道与中国移动链长基金作为长期股东及合作伙伴，在业务层面与公司形成深度协同，为芯片规模化落地提供了坚实的需求入口与验证场景。

未来，谦合益邦将持续深耕3D存算一体技术，用极致性能的芯片赋能更多应用场景，以芯为基，以存算为桥，迈向中国芯片产业的三维集成新时代。

下载日志已记录，仅供内部参考





## 谷歌122亿美元“入股”Marvell

当地时间8月19日，芯片大厂Marvell与谷歌宣布扩大定制芯片合作关系，并附带一份价值高达122亿美元的认股权证协议。消息公布后，Marvell股价应声大涨9.85%，收于237.27美元/股，而其竞争对手博通则下跌逾4.61%。

根据Marvell向美国SEC提交的文件，Marvell向谷歌发行了一份认股权证，授权谷歌以每股58美元的价格购买最多58,970,907股Marvell普通股，潜在交易总价值约121.8亿美元。若谷歌全数行使该权证，将以约7%的持股比例一跃成为Marvell的第五大股东。

谷歌与Marvell的合作并非孤例，它反映了北美AI产业链正在形成一种新的合作范式——“用订单换股权，以股权锁订单”。此前，Marvell已与亚马逊AWS签署了类似基于业绩的认股权证协议，而AMD也与Meta、OpenAI等达成了股权绑定合作。

这一趋势背后是AI基础设施投资的空前规模——各大科技巨头预计今年在该领域的支出将突破7000亿美元。在这种体量下，芯片供应商与客户之间单纯的买卖关系，正在被更深度的利益共同体模式所取代。对于Marvell而言，用约7%的股权去锁定一个长达七年、潜在营收高达1200亿美元的大客户，或许是一笔划算的长期投资。

下载日志已记录，仅供内部参考



## 博通拟融资1000亿美元,为AI企业提供算力基础设施

8月21日消息，据彭博社、CNBC等多家权威媒体报道，芯片设计巨头博通（Broadcom）正与一批金融机构展开深入谈判，计划筹集高达600亿至1000亿美元的巨额债务融资，以支持一项旨在为Anthropic等AI企业提供算力基础设施的宏大计划。

此次融资是博通、阿波罗与黑石三方在2026年6月宣布的合作关系的延伸。当时三家公司同意投入350亿美元，通过采用博通的定制化芯片与网络解决方案来扩充Anthropic的运算基础设施。该合作伙伴关系的长期目标是在2028年前向顶尖AI实验室提供超过20吉瓦（GW）的运算能力。

在第一阶段350亿美元的交易中，博通为大部分债务提供支持，阿波罗和黑石等投资者出资购买定制AI芯片，再将这些芯片出租给Anthropic使用。由于博通提供信用支持，高级债务部分得以获得投资级信用评级，从而降低整体融资成本。

博通这一超大规模融资计划的背后，是定制AI芯片市场的爆发式增长。

根据行业数据，博通2026财年第二季度AI半导体营收同比增长143%至108亿美元，合并营收增长48%至创纪录的222亿美元。摩根大通分析师预测，博通2026财年AI收入可能超过560亿美元，同比增长超过180%。博通CEO此前也表示，预计明年AI芯片销售额将突破1000亿美元。

下载日志已记录，仅供内部参考

# 03 公　司　公　告

研究创造价值

下载日志已记录，仅供内部参考



# 3.1、公司公告整理

## 中际旭创:2026年半年度报告

根据中际旭创股份有限公司2026年半年度报告

报告期内，公司实现营业收入 417.78 亿元，同比增加 182.49%；实现营业利润 172.31 亿元，同比增加 253.30%；归属于上市公司股东的净利润 136.51 亿元，同比增加 241.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130.92 亿元，同比增加 229.32%；经营活动产生的现金流量净额 18.00 亿元，同比减少 44.08%。截至 2026 年 6 月末，公司总资产 689.42 亿元，与上年度末相比增加 52.23%；总负债 248.75 亿元，与上年度末相比增加 82.00%；归属于上市公司股东净资产 398.59 亿元，与上年度末相比增加 33.91%；资产负债率 36.08%。

报告期内，受益于 AI 大客户对算力基础设施的强劲投入，公司 800G、1.6T 产品出货较快增长，占比也持续提高，且随着产品方案不断优化、运营效率继续提升，公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长。

下载日志已记录，仅供内部参考



# 3.2、公司公告整理

## 智微智能：深圳市智微智能科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之募集说明书（申报稿）

根据深圳市智微智能科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后，公司将在规定的有效期内择机发行。

本次发行的发行对象不超过35名（含35名），本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

下载日志已记录，仅供内部参考



# 3.3、公司公告整理

## 光迅科技:武汉光迅科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

根据武汉光迅科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

公司在披露2025年年度报告时，因向特定对象发行股票工作尚未完成，未进行2025年度利润分配。近期，公司已完成向特定对象发行股票相关工作。根据公司实际经营情况，综合考虑2025年度利润分配情况，公司拟进行2026年半年度利润分配。

根据公司2026年半年度财务报告(未经审计)，公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为582,178,717.03元，母公司实现净利润为544,957,257.09元。截至2026年6月30日，母公司累计可供分配的利润为4,037,294,158.70元，合并报表累计可供分配的利润为4,989,961,527.86元。根据孰低原则，本期可供上市公司股东分配的利润为4,037,294,158.70元。

结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，综合考虑2025年度利润分配情况，提出2026年半年度利润分配预案如下：公司拟以总股本827,848,838股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.70元（含税）。本次利润分配共派发现金红利306,304,070.06元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。

下载日志已记录，仅供内部参考



# 3.4、公司公告整理

## 优刻得：2026 年半年度报告

根据优刻得科技股份有限公司2026年半年度报告。

报告期内，营业收入较上年同期增加 19,057.81 万元，同比增长 24.09%，主要系公司紧跟市场需求，拓展云计算产品品类，IDC 及 AIDC 收入受益于智算中心资源的稳步投产上架，共同推动相关业务收入同比显著增长。

报告期内，利润总额较上年同期增加 2,441.28 万元，同比增长 218.97%，本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 2,397.54 万元，同比增长 150.81%，本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 6,202.30 万元，同比增长78.63%，主要系本期公司营业收入同比增长 24.09%，同时毛利率水平较去年同期提升3.4 个百分点至28.36%，带动整体利润水平提升。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,029.54 万元，同比增长43.05%，主要系本期销售回款较去年同期增加所致。

本期基本每股收益较上年同期增加 0.06 元/股、本期稀释每股收益较上年同期增加0.06元/股、本期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加0.13 元/股，主要系本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。

下载日志已记录，仅供内部参考

# 04 风　险　提　示

研究创造价值

下载日志已记录，仅供内部参考

# 风 险 提 示



中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

下载日志已记录，仅供内部参考

# 电子组介绍



庄宇：清华大学硕士，金融学&工科复合背景。10年科技行业研究经验。立足产业，做深入且前瞻的研究，主要覆盖AI硬件领域。

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

下载日志已记录，仅供内部参考



## 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 免责条款

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

## 证券投资评级说明

股票投资评级说明：

| | 投资建议 | 预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | 买入 | >20% |
| 2 | 增持 | 10%—20% |
| 3 | 中性 | -10%—10% |
| 4 | 卖出 | <-10% |

行业投资评级说明：

| | 投资建议 | 行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | 推荐 | >10% |
| 2 | 中性 | -10%—10% |
| 3 | 回避 | <-10% |

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

**相关证券市场代表性指数说明：**A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。

下载日志已记录，仅供内部参考



华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

研究创造价值

报告编号：260824214708